

## **Full Functional Electrical Test (FFT)**

1. Confirm quantity received
2. Inspect condition of packaging
3. Verify date code and lot code with OEM for validity
4. 100% physical/visual inspection for:
  - a. Lead Integrity ([JESD22-B105C](#))
  - b. Coplanarity ([JESD22-B108A](#))
  - c. Dimensions ([JESD22-B100B](#))
  - d. Visual ([JESD22-B101](#) and White Horse internal standards)
5. Sample inspection for:
  - a. Decapsulation to confirm original OEM die/chip/wafer
  - b. Radiography to verify integrity of internal hardware
  - c. Solderability ([JESD22-B102D](#))
6. 100% parametric test
  - a. Test all parameters to the range specified on the device datasheet
  - b. Sample test available to AQL standard or customer-designated
  - c. Certificate of Conformance provided
7. Re-package
  - a. Dry-pack as required by device moisture-sensitivity level (MSL)
  - b. Re-use supplied materials for trays and tubes
  - c. Use new materials for tape and reel
  - d. Packaging will be to manufacturer specifications and, if unavailable, JEDEC standard will be applied

## 全功能电性测试

1. 确认收到的元件数量。
2. 检查包装情况。
3. 与 OEM 厂商确认生产日期和批号的有效性。
4. 100% 物理/外观检测:
  - a. Lead 完整性 (JESD22-B105C)
  - b. 共面性 (JESD22-B108A)
  - c. 外部尺寸 (JESD22-B100B)
  - d. 标识 (JESD22-B101 及公司的内部标准)
5. 样品检测：
  - a. 按照取样标准进行 De-cap 试验，确认 OEM 原厂标识。
  - b. 按照取样标准进行 X-ray 试验，确认元件内部硬件结构的完整性。
  - c. 可焊性 (JESD22-B102D)
6. 参数测试：
  - a. 测试所有设计数据表上的参数
  - b. 样品的测试要符合 AQL 标准或客户的要求。
  - c. 提供 Coc
7. 重新包装 (提供真空和卷带包装材料)
  - a. 真空包装要用 MSL 装置
  - b. 盘和管要重复利用
  - c. 带子和卷轴要用新的
  - d. 包装要符合制造商的要求，入不可以，则要符合 JEDEC 的标准